

Title (en)  
Treatment of an aluminium melt

Title (de)  
Behandlung einer Aluminiumlegierungsschmelze

Title (fr)  
Procede de traitement d'un bain d'aluminium

Publication  
**EP 0967294 A1 19991229 (DE)**

Application  
**EP 98810594 A 19980626**

Priority  
EP 98810594 A 19980626

Abstract (en)  
The dross forming tendency of an aluminum-magnesium alloy melt is reduced by addition of vanadium and a very small quantity of beryllium. The susceptibility of an aluminum alloy melt containing  $\geq 2.5$  wt.% Mg to dross formation is reduced by addition of 0.02-0.15 wt.% V and less than 60 ppm Be.

Abstract (de)  
Bei einem Verfahren zur Verminderung der Anfälligkeit einer Aluminiumlegierungsschmelze mit einem Gehalt von mindestens 2.5 Gew.-% Magnesium gegen Verkratzung wird der Schmelze 0.02 bis 0.15 Gew.-% Vanadium und weniger als 60 ppm Beryllium zugegeben. Durch den Zusatz von Vanadium kann die Beryllium-Zugabe reduziert und gleichzeitig der Verkratzungswiderstand der Schmelze erhöht werden.

IPC 1-7  
**C22C 21/06**; **C22C 1/02**; **B22D 21/04**

IPC 8 full level  
**B22D 21/04** (2006.01); **C22B 9/10** (2006.01); **C22B 21/00** (2006.01); **C22C 1/02** (2006.01); **C22C 21/06** (2006.01); **C22C 21/08** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**C22C 21/06** (2013.01 - EP US); **C22C 21/08** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [XA] US 5540791 A 19960730 - MATSUO MAMORU [JP], et al
- [XA] EP 0594509 A1 19940427 - FURUKAWA ELECTRIC CO LTD [JP], et al
- [XA] EP 0110190 A1 19840613 - ITALIA ALLUMINIO [IT]
- [A] DE 2658308 A1 19780608 - ALUSUISSE
- [XA] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 011 26 December 1995 (1995-12-26)

Cited by  
DE10206035A1; CN108034871A

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0967294 A1 19991229**; AT E234941 T1 20030415; AU 4528099 A 20000117; BR 9911582 A 20010320; CA 2336016 A1 20000106; CA 2336016 C 20080212; DE 59904642 D1 20030424; EP 1090156 A1 20010411; EP 1090156 B1 20030319; ES 2193716 T3 20031101; JP 2002519510 A 20020702; JP 4287594 B2 20090701; NO 20006494 D0 20001219; NO 20006494 L 20001219; NO 331736 B1 20120312; US 6994759 B1 20060207; WO 0000654 A1 20000106

DOCDB simple family (application)  
**EP 98810594 A 19980626**; AT 99928168 T 19990621; AU 4528099 A 19990621; BR 9911582 A 19990621; CA 2336016 A 19990621; DE 59904642 T 19990621; EP 99928168 A 19990621; ES 99928168 T 19990621; IB 9901260 W 19990621; JP 2000557005 A 19990621; NO 20006494 A 20001219; US 71990000 A 20000218